

**NEWS ANNOUNCEMENT**

**FOR IMMEDIATE RELEASE**

\* 2019 年 9 月 25 日に発表されたプレスリリースの抄訳です

**タワージャズ、新しくリリースされた高度なスタック型 BSI ハイブリッドボンディング技術を発表  
同社の先端 65nm 300mm 魚津工場で製造**

**新しい製品は、車載、イベントドリブン型センサ、ハイエンドフォトグラフィなど先端の成長市場向けに、  
卓越したピクセル性能を備え大きな競争力を実現**

ミグダル ハエメク（イスラエル）、2019 年 9 月 25 日 – グローバルスペシャルティファウンドリーリーダーの[タワージャズ](#)は、本日、同社が富山県に保有する魚津工場（300mm）で製造された、先端の 65nm スタック型 BSI ハイブリッドボンディング技術を発表しました。ピクセルレベルで実現されたこの技術は、ピクセル IC 機能を 2 つのウェハに分割することにより、ピクセルサイズの大幅な縮小とパフォーマンスの向上を可能にします。この技術で製造されたセンサは、ピッチが 4µm より小さく、データレートの高速度化、消費電力の削減、パフォーマンスの向上、フォームファクターの小型化を実現し、車載、ハイエンドフォトグラフィ、イベントドリブン型センサ、タイム・オブ・フライト（ToF）など世界をリードする成長市場とアプリケーションの革新的な要件に的確に応えています。

タワージャズのシニアバイスプレジデント兼センサービジネスユニットのジェネラルマネージャーである Dr. Avi Strum は次のように述べています。「お客様が競争力を持って市場をリードしていくために、幅広いテクノロジーソリューションを提供するこの新しい高度な技術を発表できることを大変嬉しく思います。私たちは、常に戦略的で付加価値のある開発の機会とロードマップを提供する最先端の技術と最先端のピクセル性能を市場に投入することに取り組んでいます。」

タワージャズのハイブリッド BSI スタッキングは、ウェハ間でピクセル機能を分割し、イメージングトップウェーハの各フォトダイオード（PD）をボトムウェーハのピクセル回路に電気的に接続します。この新しい技術は、ハイエンドフォトグラフィ、産業用および医療用 X 線市場の大判センサ向け 1D および 2D ステッチング、さらに高度な SPAD テクノロジーを含む、確立した定評のある [CIS テクノロジー](#)を拡大、強化し、また急速に成長している自動車市場で使用され、シリコン実証済のピクセルをお客様の仕様に合わせてカスタマイズできます。

さらに、タワージャズは、最近、多様な市場セグメントに対応する [Non Imaging Sensor \(NIS\)](#) テクノロジープラットフォームポートフォリオを拡大しました。シリコンベースのセンサは、当社の成熟した定評のある 180nm CMOS 製造プロセス

スに組み込まれており、高温検知アプリケーション向けの GaN ベースのプラットフォームに加えて、現在、ガス、温度、時間・温度センシング、放射線および磁気検知用の完全なシステムオンチップ、および独自の環境センサ技術が含まれています。タワージャズの Non Imaging Sensor プラットフォームは、無償で設計 IP と PDK を提供し、設計サポートと迅速な市場投入を可能にします。

Dr. Avi Strum は、2019 年 9 月 25～27 日にフランスのグルノーブルで開催される予定の MEMS & Imaging Sensor Summit で基調講演を行います。

講演タイトル : **Considerations of Optical Fingerprint and 3D Face Recognition Sensors for Cellular Security Applications**

日時 : 9 月 25 日午後 5 時 30 分から午後 6 時 00 分 (サミットのオープニングセッション内)

サミットの詳細については[こちら](#)をご覧ください。

タワージャズの CMOS イメージセンサテクノロジーについては[こちら](#)

タワージャズの Non Imaging Sensor テクノロジーについては[こちら](#)

## タワージャズについて

タワーセミコンダクター株式会社 (NASDAQ: TSEM, TASE:TSEM) は、その子会社とタワージャズというブランド名でグローバルに事業を展開するスペシャルティファンドリのリーダーです。タワージャズは、コンシューマー、産業機械、車載用、医療用、航空宇宙・防衛などの成長市場で次世代の集積回路(IC)を生産しており、SiGe、BiCMOS、ミックスドシグナル/CMOS、RF CMOS、CMOS イメージセンサ、パワーマネジメント(BCD および 700V)、MEMS など、カスタマイズが可能なプロセスプラットフォームを幅広く提供しています。また迅速かつ正確なデザインサイクルを実現する世界クラスのデザインイネーブルメントを提供し、IDM やキャパシティ拡大を必要とするファブレス企業向けには Transfer Optimization and development Process Services(TOPS)を提供しています。複数のファブを使ってサービスを提供するために、タワージャズはイスラエルに 2 か所(150mm と 200mm)、米国に 2 か所(200mm)、そしてパナソニックセミコンダクターソリューションズ(株)とのパートナーシップによる日本に 3 か所(200mm と 300mm)の生産拠点を保有しています。詳細は [www.towerjazz.com](http://www.towerjazz.com) をご覧ください。

**TowerJazz Company Contact:** Orit Shahr | +972-74-7377440 | [oritsha@towersemi.com](mailto:oritsha@towersemi.com)

**TowerJazz Investor Relations Contact:** Noit Levi | +972-4-604-7066 | [noit.levi@towerjazz.com](mailto:noit.levi@towerjazz.com)